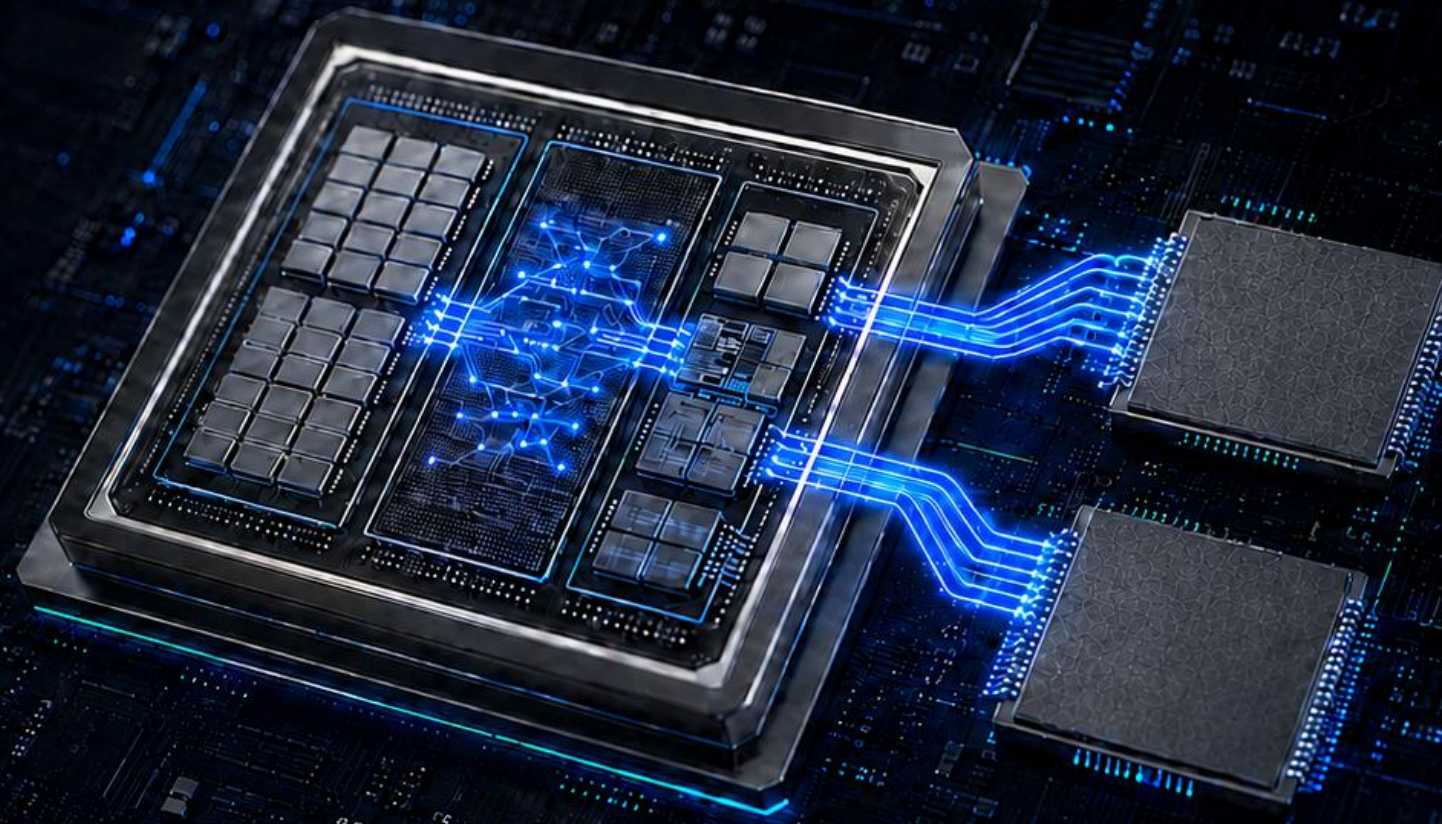
오픈엣지테크놀로지

고성능 SoC 설계의 핵심인
NPU 및 메모리 서브시스템 IP 기업



INVESTOR RELATIONS 2026

KOSDAQ 394280 | Edge NPU & Memory Subsystem IP | 2026.09.30 기준

OPENEDGES

OPENEDGES Technology, Inc.

DISCLAIMER

본 자료는 오픈엣지테크놀로지 주식회사(이하 "회사")가 주주 및 투자자의 이해를 돕기 위해 작성한 참고 자료입니다.

재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 기준입니다. 회사는 사업연도 재무제표에 대해 감사를, 반기 재무제표에 대해 검토를 받으며, 제1분기 및 제3분기 수치는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 내부 결산 자료로 향후 변경될 수 있습니다. 상세 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 보고서를 통해 확인하시기 바라며, 본 자료와 상이한 경우 공시 자료가 우선합니다.

본 자료에는 '예상', '전망', '계획', '목표', '(E)' 등으로 표시된 예측정보가 포함되어 있습니다. 이는 작성 시점의 판단에 근거한 것으로 경영환경 및 시장 상황의 변화에 따라 실제 결과와 중대한 차이가 발생할 수 있으며, 회사는 그 실현을 보증하지 않습니다.

본 자료는 표지에 기재된 기준일 현재 입수 가능한 정보를 바탕으로 작성되었습니다. 인용된 제3자 시장자료를 포함하여 정보의 정확성과 완전성을 보장하지 않으며, 회사는 이를 갱신할 의무를 부담하지 않습니다.

본 자료는 증권의 청약 권유를 목적으로 하지 않으며 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다. 회사는 본 자료의 이용으로 발생하는 손실에 대해 책임을 부담하지 않으며, 무단 복제 및 배포를 금합니다.

OPENEDGES

시스템반도체 Ecosystem 내 반도체 IP 산업의 중요성

IP 설계는 밸류체인의 최선단에서 수요 발생 2~3년 전 선행 개발하여 SoC 개발기간 단축 및 개발 Risk 경감

IP 설계
사전 검증된 반도체 기능 블록 설계
플레이어 **50개 내외**
시장규모 **$10B**

팹리스
IP를 조합하여 SoC 설계 (Frontend 설계 담당)
플레이어 **3,500개 이상**
시장규모 **$214B**

디자인하우스
제조 도면으로 변환 (Backend 설계 담당)
플레이어 **약 80개**
시장규모 **$9B**

파운드리
반도체 칩 제조
플레이어 **약 20개**
시장규모 **$148B**

OSAT
패키징·테스트
플레이어 **약 100개**
시장규모 **$43B**

2~3년(IP개발기간) | 0.5~1년 | 0.5년 | 0.5년(Foundry&OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test))

IP개발 Kick-off → **SoC 설계 Kick-off (IP 라이선스)** → Tape-out → SoC 제작완료

SoC 개발기간 1.5~2년

IP 라이선싱을 하는 이유

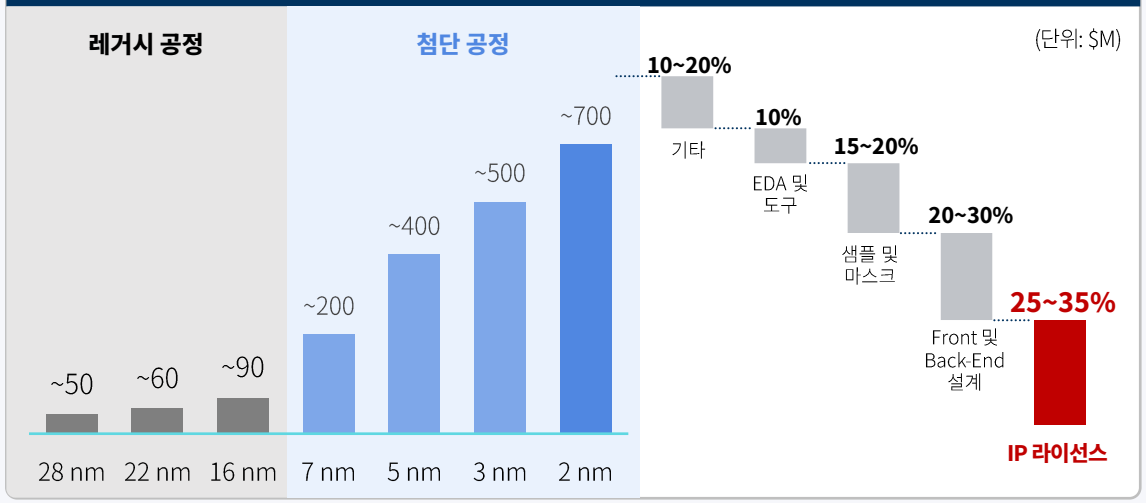
■ **설계 복잡도와 비용 상승**
공정 미세화에 따라 선단 공정 SoC 1건의 개발비가 최대 1조원 수준까지 상승
→ 미검증 IP 투입에 따른 칩 전체 실패 리스크 증가

■ **시장 요구사항 증가**
짧아지는 Time-to-market 요구사항 & 개발해야 할 칩 종류 및 개수 증가

IP 활용

SoC 개발기간 단축	미리 검증된 IP 활용, **칩 개발기간 대폭 단축 (2~3년)**
개발비용·실패 리스크 경감	검증되지 않은 IP 사용으로 인한 **프로젝트 실패 위험 감소**
설계 인프라 구축 효과	검증된 블록 재사용을 통한 **칩 개발 효율 극대화**

칩 설계 비용



※ Source: PwC Global semiconductor industry outlook 2026 (2026.06)

01

OPENEDGES

INDUSTRY OVERVIEW

Total Memory Subsystem IP Provider

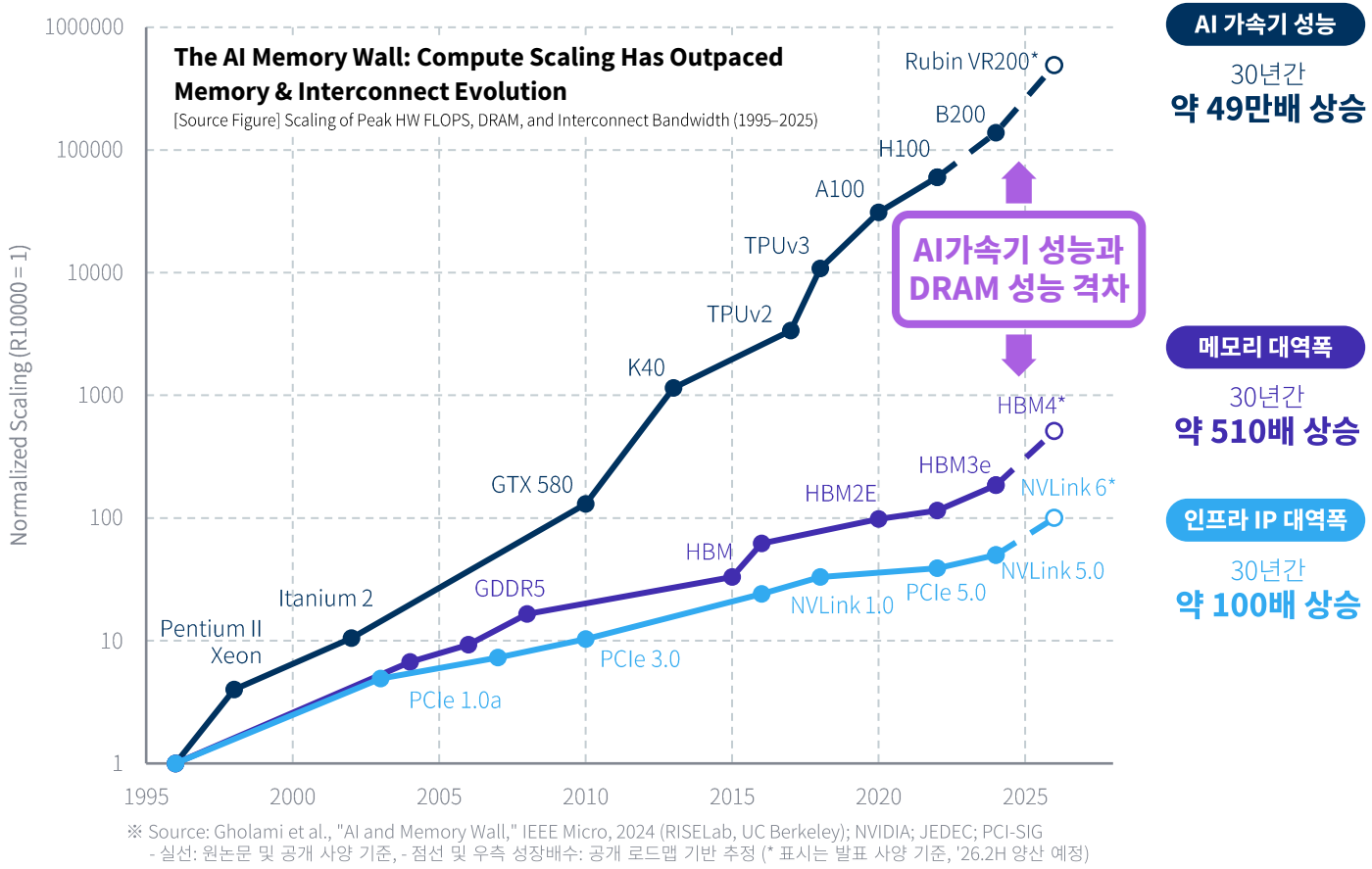
OPENEDGES

AI 반도체의 핵심 병목: 연산 성능보다 느린 데이터 공급

AI 가속기 기술 발전에 따라 데이터 요구량과 DRAM에서 제공하는 성능 간 격차 확대

■ 메모리 월(Memory Wall)이란?

데이터 공급이 연산을 따라가지 못해 전체 시스템 성능이 제한되는 현상



※ Source: Gholami et al., "AI and Memory Wall," IEEE Micro, 2024 (RISELab, UC Berkeley); NVIDIA; JEDEC; PCI-SIG
- 실선: 원논문 및 공개 사양 기준, - 점선 및 우측 성장배수: 공개 로드맵 기반 추정 (* 표시는 발표 사양 기준, '26.2H 양산 예정)

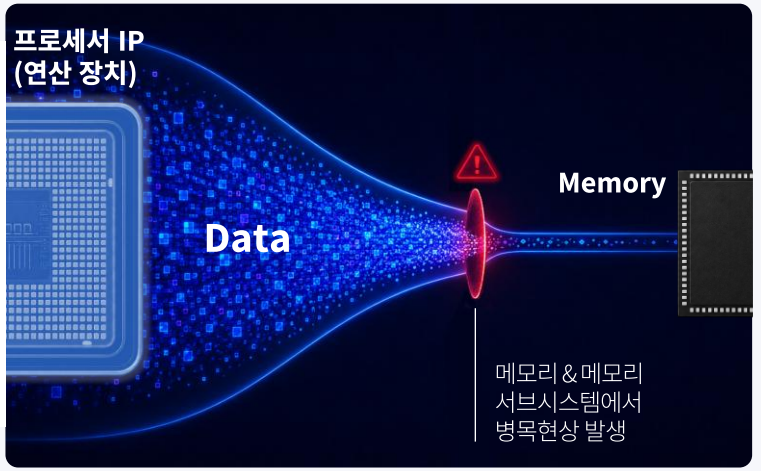
메모리 월(Memory Wall)

연산 성능
AI 가속기 연산 성능의 급격한 향상

>

메모리 대역폭
연산 성능 대비 메모리 대역폭 부족

데이터 병목으로 AI 가속기 성능 활용 제한



연산기가 아무리 빨라도 데이터가 제때 도달하지 못하면 성능 구현의 한계에 도달

OPENEDGES

Edge AI 확산에 따른 LPDDR 적용 확대

LPDDR = Edge AI 디바이스의 핵심 메모리 → 오픈엣지는 LPDDR 메모리 서브시스템 IP(NoC·MC·PHY)에 집중

Cloud AI

- 데이터센터 바탕의 학습 · 추론
- 전력 · 면적 제약이 상대적으로 작음

소수 대형 팹리스

- 자체 설계 및 내재화 경향
- 외부 IP 채택 여지 낮은 구조



On-Device AI (당사 집중 영역)

- 기기 안에서 실시간 추론
- 제한된 전력 · 대역폭 下 효율적인 데이터 공급

팹리스 3,500개 이상

- 중견 및 중소 기업 다변화
- 자체설계 여력 낮아 검증된 IP를 사용하는 구조



Edge AI 디바이스의 요구 "Higher Performance · Higher Memory Bandwidth · Lower Power"

Edge AI 디바이스, 전 산업 영역으로 확산

스마트폰·PC에서 자동차·로봇(Physical AI)까지 AI 탑재 가속, LPDDR 기반 SoC가 주류

GenAI 스마트폰 출하 비중	AI PC 출하 비중	차량당 DRAM 탑재량 (자율주행 고도화)	Physical AI 기기 누적 출하량
52% '27년(E)	**50%** '28년(E)	**300GB+** Lv4	**1.45억대** '25년~'35년(E)
'25년 36% → '27년(E) 52%	'25년 31% → '28년(E) 50%	현재 평균 16GB → Lv4 300GB+ 전망	차량 0.38 · 로봇 0.48 · 드론 0.59
Counterpoint, '26.06	Gartner, '25.08 / '26.02	Micron, '26.03	Counterpoint, '26.04

Edge AI의 메모리 = LPDDR

전력·발열·면적 제약 → '전력당 대역폭' 극대화가 메모리 선택 기준

5× '29년(E) Edge 기기 1대당 연산 성능 5배 (vs '26년), 전력 한도는 동일

Gartner Predicts 2026

LPDDR 세대별 속도 (JEDEC)

LPDDR4X 4.3 Gbps › LPDDR5X 8.5 Gbps › LPDDR6 14.4 Gbps

LPDDR 적용 영역 확대

Edge AI 디바이스(모바일, 자동차, 로봇 등)에서 AI 서버(SOCAMM)까지 활용처 확대

스마트폰 → AI PC → 자동차 → 로봇 → AI 서버

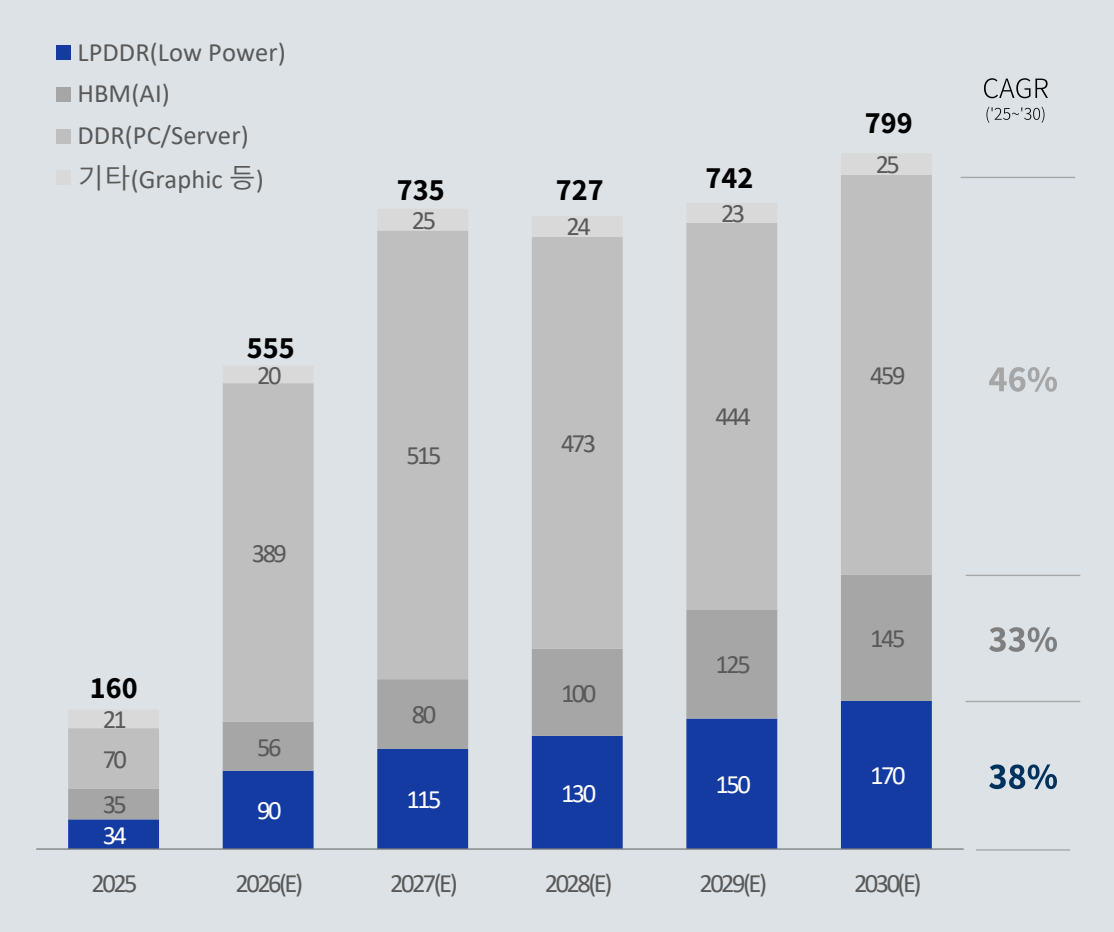
※ Source: Counterpoint Research (2026.06 / 2026.04), Gartner (2025.08 / 2026.02 / 2026.03), Micron FQ2'26 Earnings Call (2026.03), TrendForce (2026.06), JEDEC · 배수는 상기 수치 기반 계산값, SOCAMM (System-on-Chip Attached Memory Module)

반도체 IP 시장의 성장

Edge Application 다변화에 따른 신규 SoC 개발 수요 증가와 그에 기반한 LPDDR 메모리용 Infra IP 시장의 고성장 기대

■ 글로벌 DRAM 시장 전망

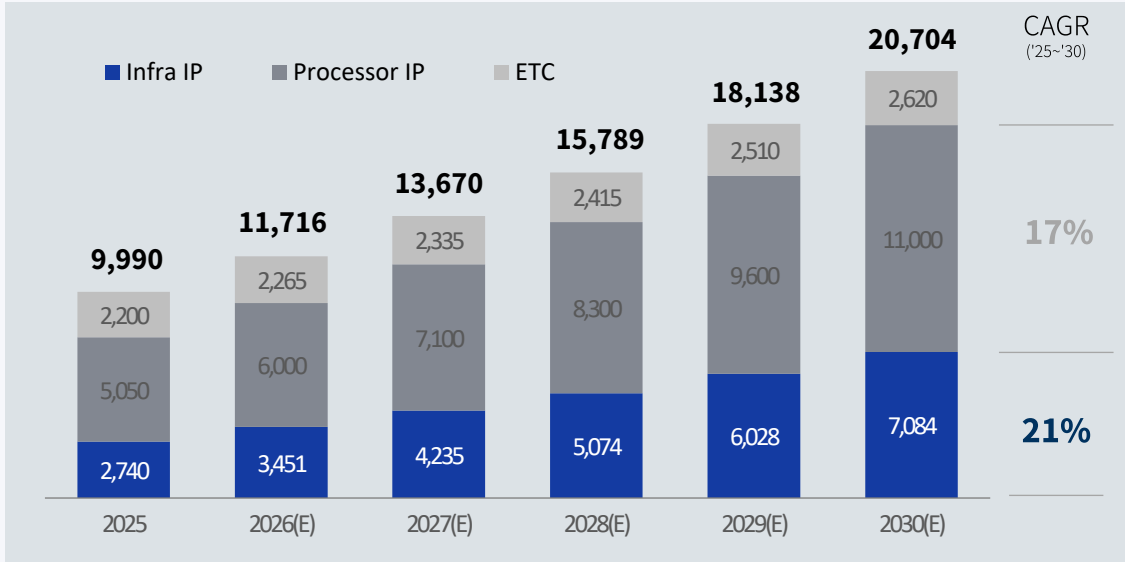
(단위: $B)



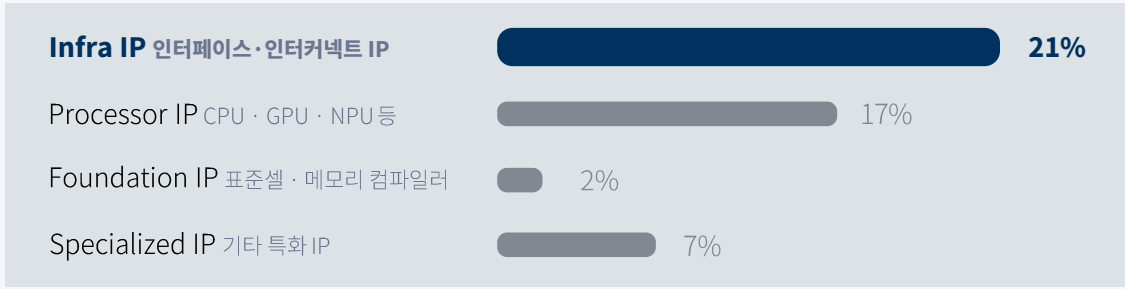
※ Source: WSTS Spring 2026 (2026.06) 전망에서 NAND 제외, 당사 추정

■ 글로벌 반도체 IP 시장 전망

(단위: $M)



■ IP 세그먼트별 성장률



※ Source: IPnest (2026.04), Interface IP, Interconnect IP 등 데이터 이동 관련 IP, 당사 추정

※ 세그먼트 CAGR: '25~'30 기준

02

OPENEDGES

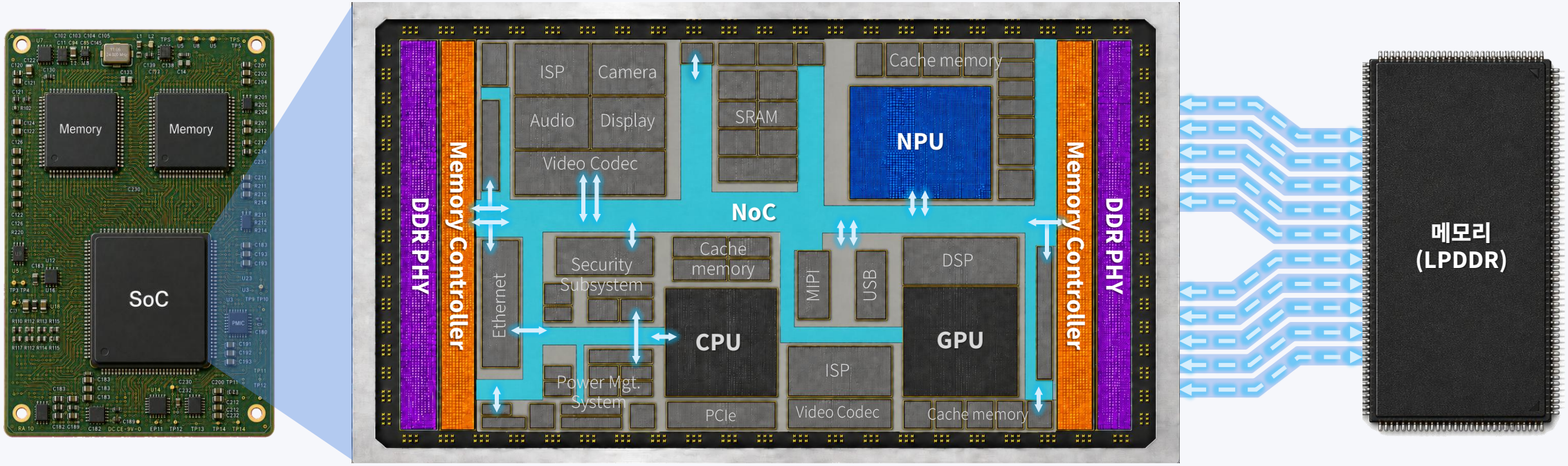
BUSINESS HIGHLIGHTS

Total Memory Subsystem IP Provider

OPENEDGES

오픈엣지는 AI 반도체 내 데이터 이동 전 구간을 연결하는 Total IP Solution을 제공

AI 반도체의 두뇌에 해당하는 NPU와, DRAM 데이터를 SoC 내 각 IP에 효율적으로 전달하는 Memory Subsystem IP



< System On Chip(SoC) Floor Plan 예시 >

OPENEDGES IP
(데이터 병목 구간 전체를 커버)

메모리 서브시스템(데이터 병목의 핵심구간)

① NPU
ENLIGHT
인공지능 신경망 연산
엣지 최적화 신경망 처리 프로세서
- 보안카메라· 자율주행

② NoC
OIC (On-Chip Interconnect)
SoC 내 데이터 이동
SoC 내부 연산 블록 사이의 데이터 흐름을 제어하는 연결망

③ Memory Controller
OMC (OPENEDGES Memory Controller)
메모리 접근 제어
SoC와 DRAM 사이의 고속 통신을 스케줄링하고 제어

④ DDR PHY
OPHY (OPENEDGES DDR PHY)
DRAM과의 고속 신호 I/F
DRAM과 직접 맞닿는 물리계층 – 공정마다 재설계 필요

DRAM
대용량 데이터 저장

OPENEDGES

Mass Market 공정에서 선제적인 LPDDR IP 기술 개발에 집중

최신 LPDDR6용 IP 개발 및 상업화에 성공한 기술력을 기반으로 선단공정 Coverage를 지속 확대



팹리스 고객의 가격 접근성이 높은 Mass Market 공정을 중심으로, 최신 메모리 표준·최고 속도를 지원하는 IP 라인업 지속 확대

고객사의 첨단 IP 수요를 면밀히 센싱하여 5nm 미만 공정으로 지속 IP Coverage 확대할 예정

■ 공정 노드별 LPDDR IP Coverage: 삼성 파운드리/TSMC Mass Market 공정(4~12nm)

■ 당사 보유 ★ 오픈엣지 단독제공 IP

LPDDR 표준 (속도)	SAMSUNG			tsmc		
	4nm	5nm	8nm	6nm	7nm	12nm
LPDDR6 (최대 14.4Gbps)	■	-	-	-	-	-
LPDDR5X (최대 8.5Gbps)		■	■	■	★	★
LPDDR5 (최대 6.4Gbps)		■	■	■	■	■
LPDDR4X (최대 4.3Gbps)	-	■	■	■	■	■
LPDDR4 (최대 3.2Gbps)	-	■	■	■	■	■

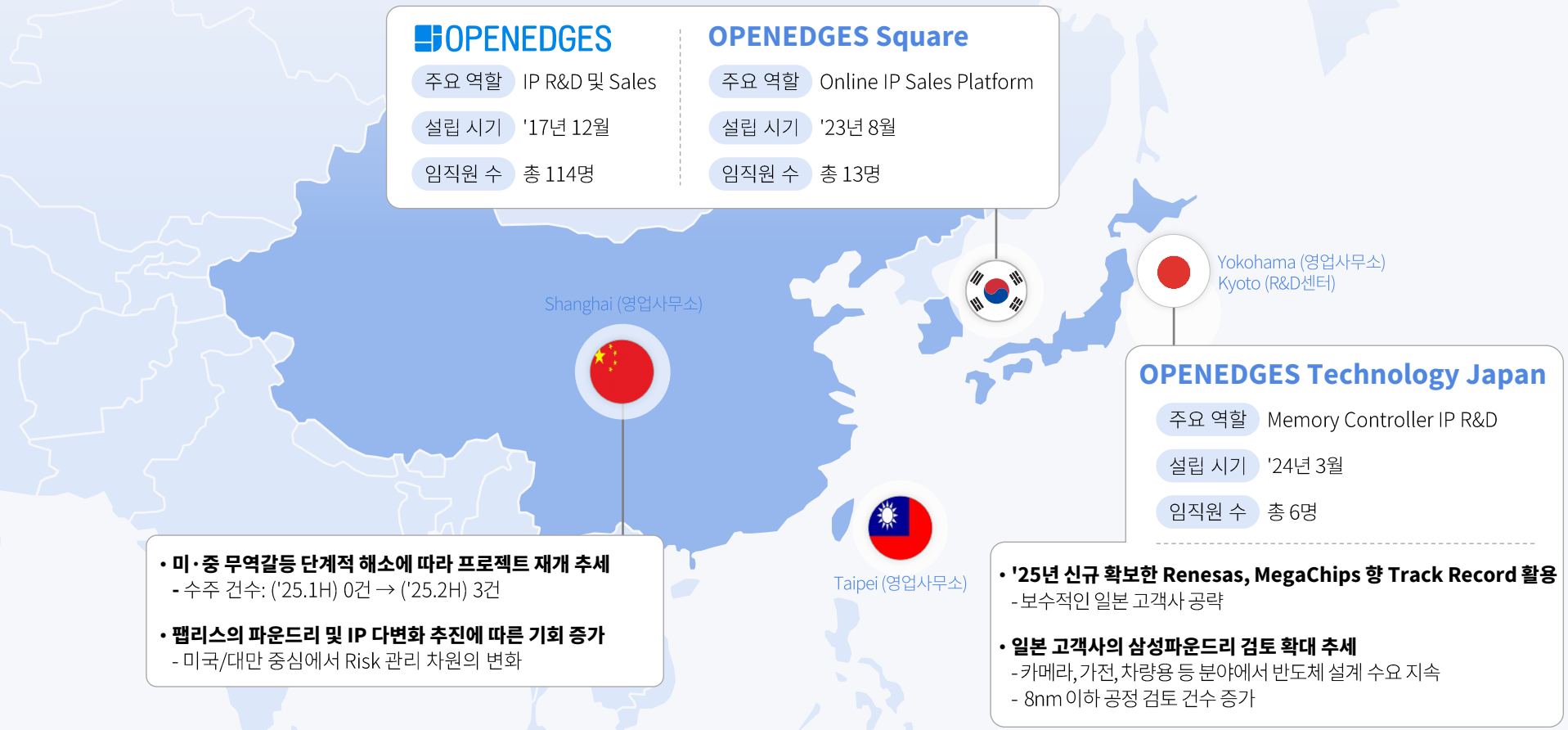
'26년초 개발 착수 후 누적 수주 100억원 달성, '26.4Q 개발 완료

경쟁사 대비 1년 이상 선제 개발 후 4건 수주 완료

Mass Market 공정(4~12nm) 중심 IP Coverage 확대

해외시장 공략을 통한 수주 확대로 안정적 성장 기반 구축

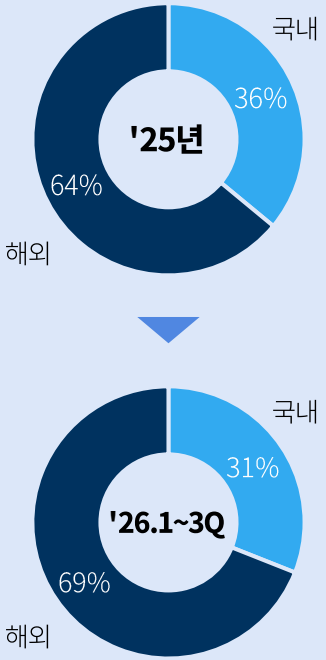
일본, 중국, 대만 등 글로벌 영업 사무소를 통한 해외 매출 지속 확대



※ '26년 9월말 기준

해외 매출 비중

(최종 고객사 기준)



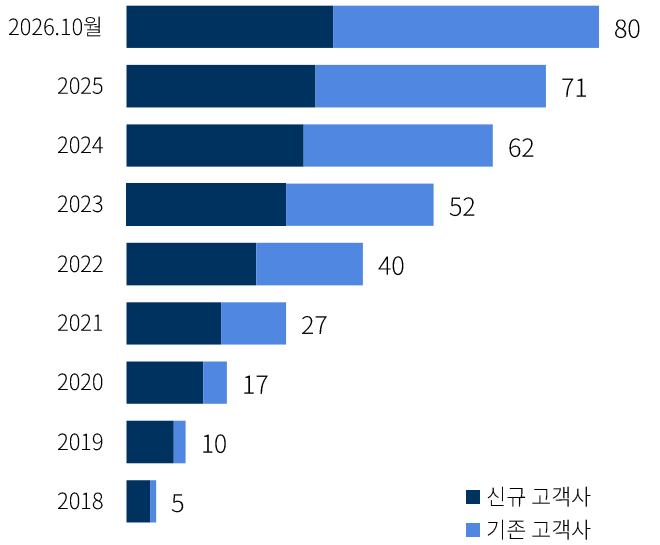
해외 고객 기반 확대로
글로벌 매출 성장 기반 강화

OPENEDGES

글로벌 고객사 레퍼런스 축적으로 트랙레코드 지속 확대

기존 고객사 향 검증된 IP의 반복 수주가 신규 프로젝트로 확대되며 매출 성장 견인

연도별 누적 라이선스 계약 건수



※계약 건수는 IP라이선스 프로젝트 기준 내부 집계로, 공시 기준 계약 건수와 다를 수 있음

■ 다양한 산업군에 걸쳐 80건의 누적 라이선스 계약 확보 (확보 고객사 30개사+)

지능형 보안카메라

VISIONEXT a Hanwha company
nextchip
eyenix the great eyes
PnpNetwork Technologies Inc

자율주행 / 차량 인식

AISIN
Telechips
nextchip
GAONCHIPS

서버 / 저장장치

SAMSUNG
SK 하이닉스
asicland
novachips
글로벌 I社
GLENFLY

IoT / 모바일

JLQ TECHNOLOGY
MONTAGE Technology
SENSCOMM
GCT

AI

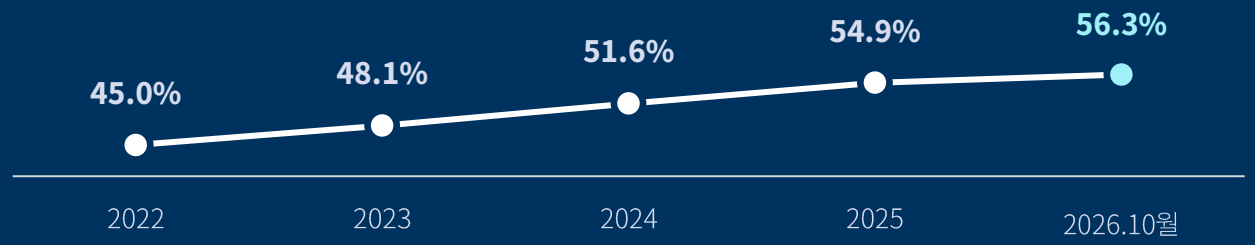
Micron
VeriSilicon
SEMI FIVE
mobilint

기타 (산업용·카메라 등)

LX Semicon
EVERYWHERE IN YOUR LIFE
RENESAS
MegaChips

신규 계약 10건 중 6건이 기존 고객

검증된 IP에 대한 고객 신뢰 축적으로,
기존 고객의 신규 프로젝트 재계약 비중이 지속 증가



03

OPENEDGES

FINANCIAL RESULTS

Total Memory Subsystem IP Provider

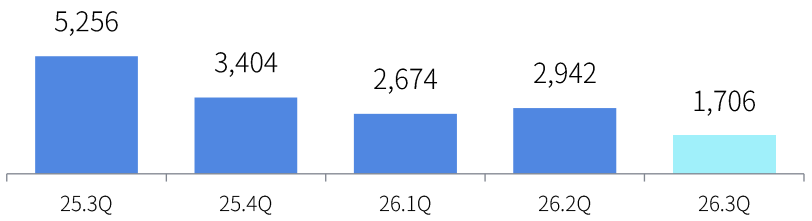
2026 3Q 경영 실적

(단위: 백만원)

매출액
Sales Revenue

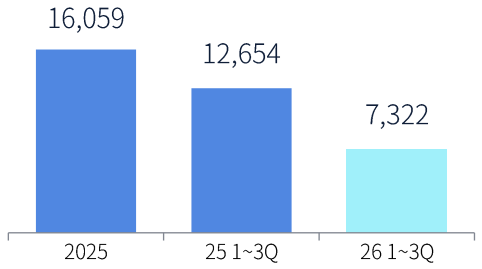
26.3Q
KRW 1,706M

분기별 2025.3Q – 2026.3Q



'26.3Q
YoY -68%
QoQ -42%

연간 · 누적 1~3Q YoY



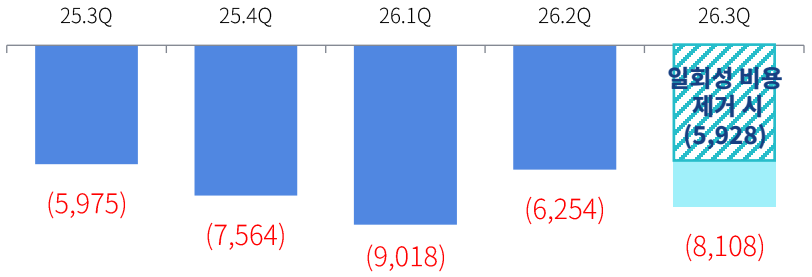
'26.1~3Q YoY
-42%

영업이익
Operating Income

26.3Q
KRW -8,108M

*** 일회성 비용(해외 자회사 구조조정 비용) 제거 시 KRW -5,928M**

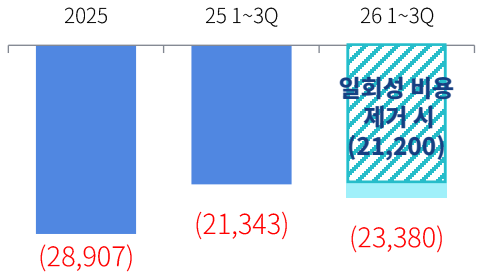
분기별 2025.3Q – 2026.3Q



'26.3Q
YoY 적자확대
QoQ 적자확대

*** 일회성 비용 제거 시 YoY, QoQ 개선**

연간 · 누적 1~3Q YoY



'26.1~3Q YoY
적자확대

*** 일회성 비용 제거 시 YoY 개선**

'26. 3Q Review

당초 계획 대비 수주 지연 및 자회사 청산비용 반영으로 수익성 악화

- **매출 감소**: 예상 대비 수주 지연으로 3분기 매출 1,706백만원(YoY -68%)
- **일회성 비용 반영**: 캐나다 자회사 청산 비용 21.8억원(영업비용) 및 관련 손상차손 13.5억원(영업외손익) 반영

'26. 4Q Outlook

매출 증가 및 비용구조 개선으로 수익성 제고 예상

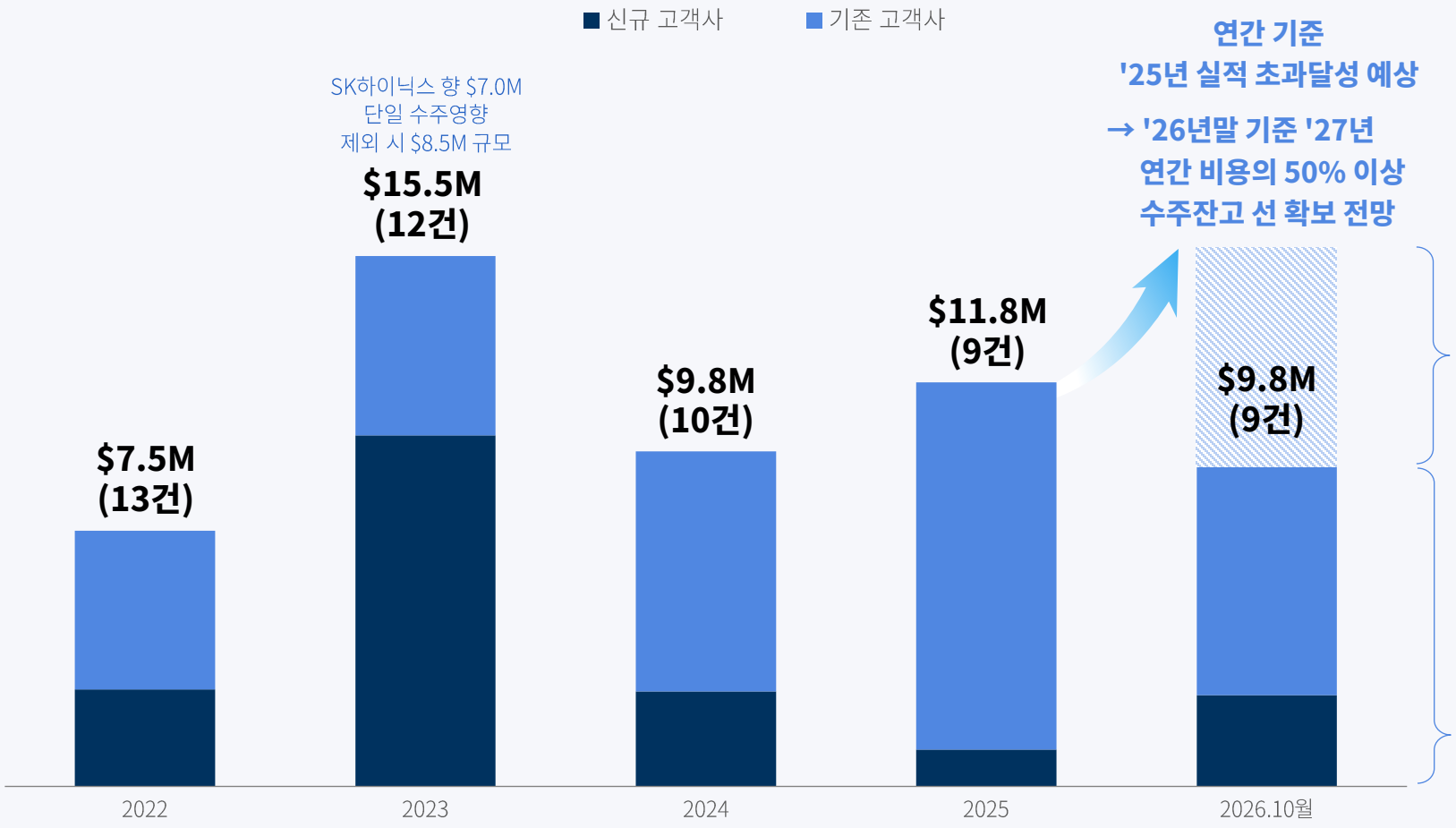
- **매출 회복**: '26.10월 국내 AI 반도체 기업과 67억원 규모 IP 라이선스 계약체결 등 재개된 수주계약 이행에 따른 매출 증가 전망
- **비용 구조 개선**: 3분기 자회사 청산 완료로 분기 비용 60억원 내외 규모로 감소

OPENEDGES

2026 수주 현황

팹리스·디자인하우스·세트기업 등 다양한 세일즈 채널 기반, 고객사 Pool을 확대하여 안정적 수주 기반 확보

■ 오픈엣지 수주금액 및 건수 추이



잔여 기간 수주 확보 전략



국내 IP 수요 적극 대응

K-On-Device AI 반도체 기술개발 사업(총 8천억원 규모) 등

※ 당사가 제공이 어려운 과제를 제외한 모든 상업과제를 100% 수주 목표



해외 수주규모 확대

중국/일본시장 중심 공략 중



고판가 계약 확대

최신 LPDDR6 IP 수요 급증 및 Memory Subsystem(NoC/MC/PHY) 통합 IP 솔루션 공급 논의 확대 중

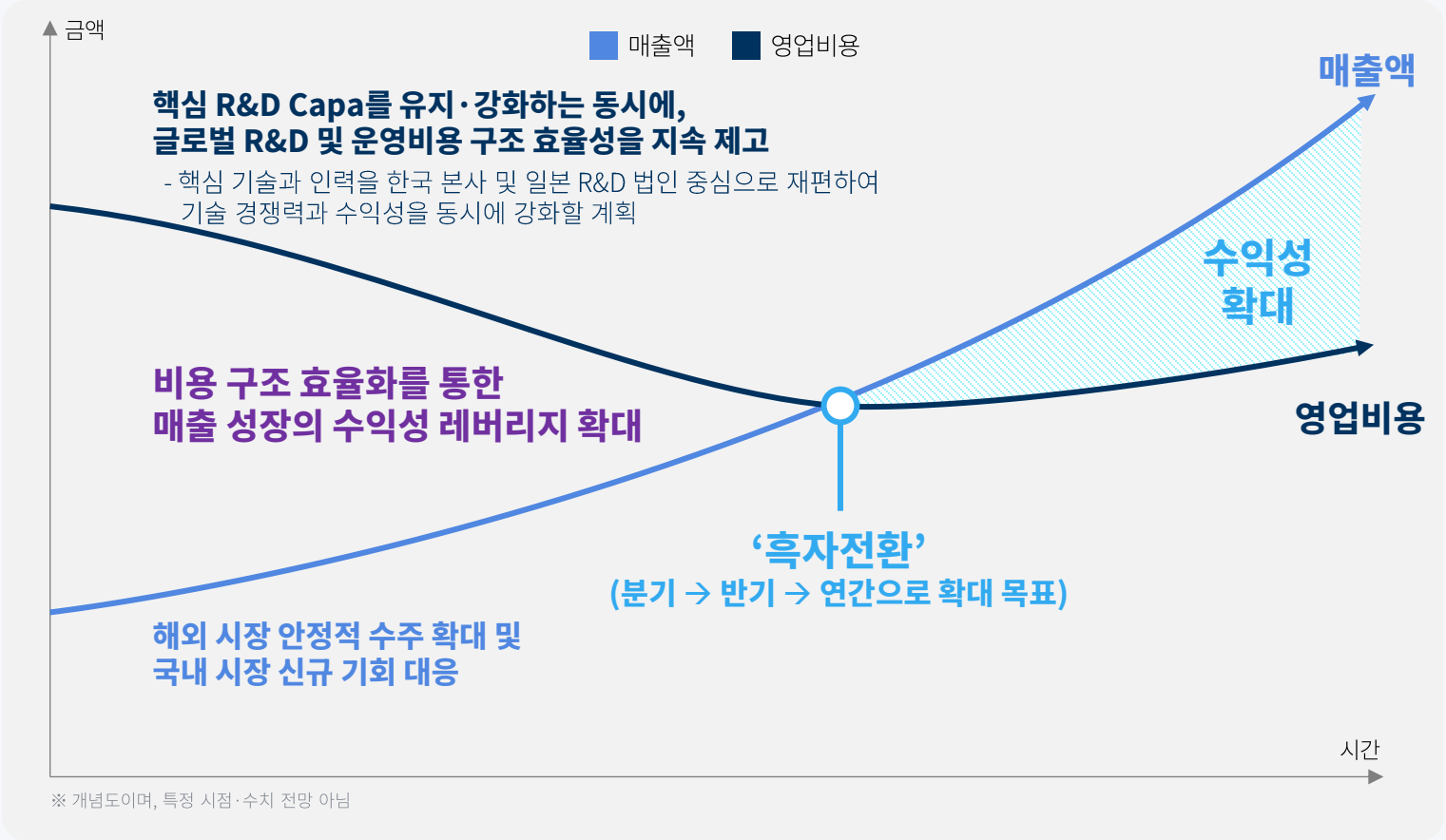
'26.10월 말 누적 실적 : $9.8M ('25년 연간 실적 대비 82%)

※ 계약 건수는 IP라이선스 프로젝트 기준 내부 집계로, 공시 기준 계약 건수와 다를 수 있음

비용 구조 효율화 및 수주 회복을 통한 수익성 개선 추진

중단기적으로 회사 운영 기조를 성장 중심에서 수익성 구조로 전환

■ 오픈엣지 중단기 매출·영업이익 전망



비용 절감 요인

- **해외 R&D센터 거점 축소**
  ※ 미국('25.4Q), 캐나다('26.3Q) 자회사 청산
- **AI Tool**을 활용한 R&D 생산성 제고
- **정부 R&D과제 증가**에 따른 비용지원 확대
  ※ 정부지원금은 비용차감 회계 처리
- Office Infra 축소, 외주 내재화 등 **기타비용 감소**

'26.3Q 1회성 TSS 청산비용 21.8억원 반영
4Q부터 TSS 운영비용 미발생

비용 효율화로 수익성 개선

※ 라이선스 매출은 IP 설계 산출물(Design DB) 인도 시점에 일시 인식



04

Total Memory Subsystem
IP Provider

APPENDIX

요약 연결재무제표

■ 요약 연결재무상태표

(단위: 백만원)

	2026.3Q	2025	2024	2023
유동자산	27,182	30,138	73,965	29,843
비유동자산	14,915	17,407	12,713	14,849
자산총계	**42,097**	**47,545**	**86,678**	**44,692**
유동부채	22,604	24,851	21,526	19,750
비유동부채	6,980	5,625	4,435	4,371
부채총계	**29,584**	**30,476**	**25,961**	**24,121**
자본금	2,749	2,501	2,482	2,146
자본잉여금	188,300	167,201	164,313	98,259
기타자본항목	597	142	4,633	3,577
이익잉여금(결손금)	(179,133)	(152,774)	(110,711)	(83,412)
자본총계	**12,513**	**17,069**	**60,717**	**20,571**

■ 요약 연결손익계산서

(단위: 백만원)

	2026.3Q	2026.2Q	증감	증감(%)
매출액	**1,706**	**2,942**	**(1,236)**	**(42.0%)**
영업비용	**9,814**	**9,197**	**617**	**6.7%**
R&D 비용	5,788	7,285	(1,497)	(20.5%)
기타영업비용	1,846	1,912	(66)	(3.5%)
구조조정비용	2,180	-	2,180	-
영업이익	**(8,108)**	**(6,254)**	**(1,854)**	**적자 확대**
기타수익	3	36	(33)	(91.7%)
기타비용	83	58	25	43.1%
금융수익	549	506	43	8.5%
금융비용	433	336	97	28.9%
구조조정비용	1,345	-	1,345	-
세전이익	**(9,417)**	**(6,107)**	**(3,310)**	**적자 확대**
법인세비용	-	-	-	-
당기순이익	**(9,417)**	**(6,107)**	**(3,310)**	**적자 확대**

재무 요약(Financial Summary)

(단위: 백만원)

연결재무제표	2021	2022	2023	2024	2025				연간	1Q26	2Q26	3Q26
					1Q25	2Q25	3Q25	4Q25				
매출액	**5,186**	**10,012**	**19,595**	**15,328**	**4,801**	**2,597**	**5,256**	**3,404**	**16,059**	**2,674**	**2,942**	**1,706**
라이선스	4,342	8,593	14,852	10,997	3,361	1,184	4,049	2,265	10,858	1,859	1,981	912
유지보수	808	1,387	2,308	3,290	1,112	1,116	1,000	970	4,198	741	845	661
로열티	35	32	71	83	4	25	22	51	102	4	35	31
기타매출	-	-	2,363	958	324	273	185	118	901	69	81	102
비용	**16,241**	**35,273**	**35,458**	**39,941**	**11,411**	**11,355**	**11,231**	**10,969**	**44,966**	**11,691**	**9,197**	**9,814**
R&D 비용	10,654	27,710	27,184	30,900	8,828	9,026	8,903	10,288	37,045	9,391	7,285	7,968
기타영업비용	5,587	7,563	8,275	9,041	2,583	2,330	2,328	680	7,921	2,300	1,912	1,846
영업이익	**(11,055)**	**(25,261)**	**(15,864)**	**(24,612)**	**(6,610)**	**(8,758)**	**(5,975)**	**(7,564)**	**(28,907)**	**(9,018)**	**(6,254)**	**(8,108)**
법인세 차감전 이익	(14,524)	(24,846)	(14,510)	(26,822)	(6,367)	(8,887)	(5,621)	(8,521)	(29,395)	(9,135)	(6,107)	(9,417)
당기순이익	(14,608)	(25,227)	(14,856)	(27,287)	(6,367)	(8,889)	(5,637)	(9,240)	(30,133)	(9,135)	(6,107)	(9,417)

※ 연결 재무제표 기준

Appendix

인력 현황

메모리 서브시스템 IP와 NPU IP 자체 개발 역량을 보유한 반도체 IP 전문기업



전사 R&D 인력현황

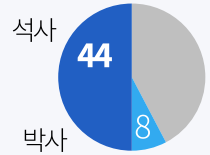
총 인원(133명)의

87%

116명
R&D인력

R&D 인력 중
석박사(52명) 비중

45%



지역별 현황

한국 **127명**

일본 **6명**



이성현
대표이사/CEO

SAMSUNG | SAMSUNG ADVANCED INSTITUTE OF TECHNOLOGY

서울대학교 전기·컴퓨터공학 박사 수료
'17~現 오픈엣지테크놀로지㈜대표이사
'08~'15 삼성전자 수석연구원 (Exynos 개발)
'07~'08 삼성종합기술원



김양수
Memory Controller팀장

SAMSUNG

서울대학교 전기공학 석사
'17~現 오픈엣지테크놀로지㈜MC팀장
'12~'16 삼성전자 선임연구원



최정환
NPU 팀장

SK hynix | SAMSUNG

Purdue University 전기 및 컴퓨터공학 박사
'18~現 오픈엣지테크놀로지㈜NPU팀장
'15~'18 SK 하이닉스 수석연구원
'09~'14 삼성전자 Architecture Lab 파트장



김대우
Verification 팀장

MIDAS | SAMSUNG

서울대학교 건축학 석사
'22~現 오픈엣지테크놀로지㈜Verification팀장
'05~'22 삼성전자 Digital Technology팀 파트장
'01~'05 MIDAS IT



문상훈
VP of Engineering

SK hynix | SAMSUNG

서울대학교 컴퓨터공학 석사
'18~現 오픈엣지테크놀로지㈜ VP of Engineering
'17~'18 SK 하이닉스 Memory System연구소 파트장
'00~'16 삼성전자 AP개발팀 파트장



이재광
NoC팀장

Silicon Mitus | cadence

Stanford University 전기공학 박사
'21~現 오픈엣지테크놀로지㈜NoC팀장
'20~'21 아나패스 엔지니어
'09~'20 실리콘마이터스, 케이던스디자인



김수호
PHY팀장

SK hynix | SAMSUNG

성균관대학교 전기공학 석사
'21~現 오픈엣지테크놀로지㈜PHY팀장
'18~'21 SK 하이닉스 NAND IP 개발팀장
'98~'17 삼성전자 수석연구원



Takashi Yamada
OTJ / Regional VP

socionext | Panasonic

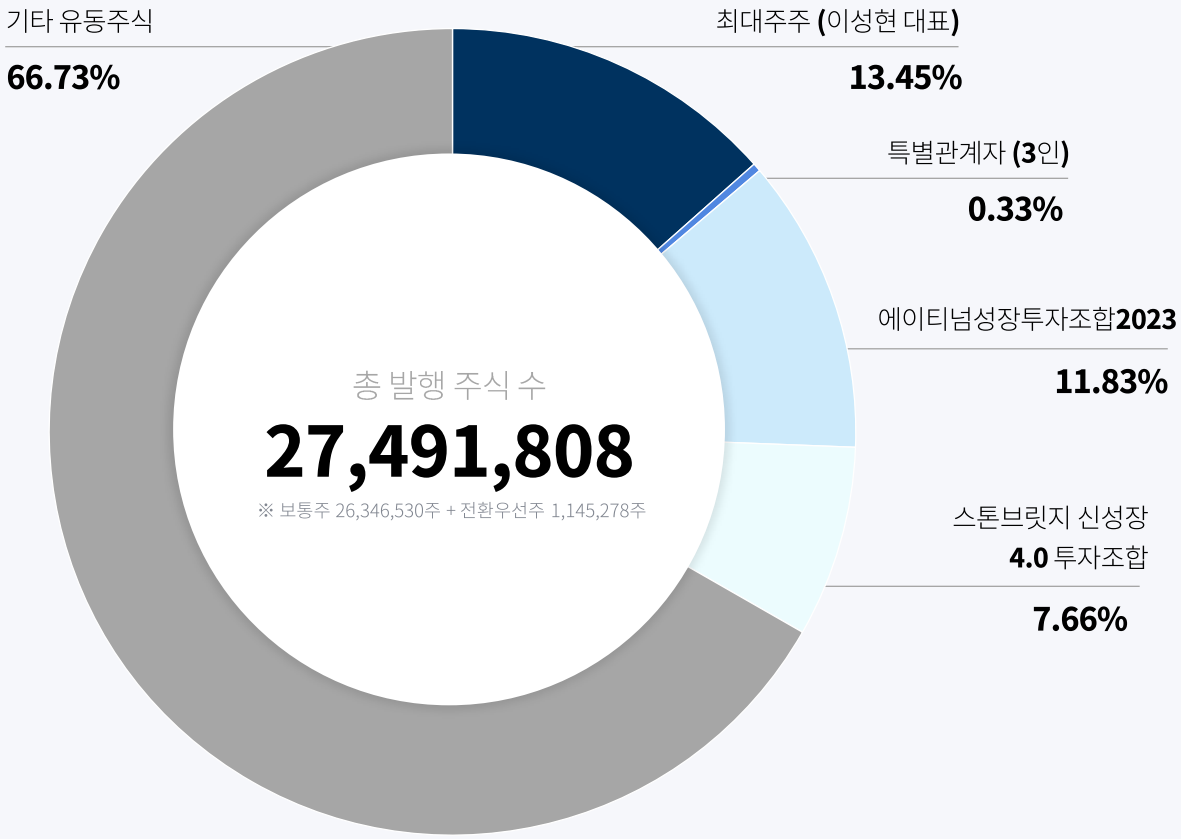
Tokyo Denki University 전기공학 학사
'24~現 오픈엣지테크놀로지 일본법인 Regional VP
'15~'24 SOCIONEXT Inc., Principal Engineer
'88~'15 PANASONIC Corporation

※ '26년 9월말 기준

주주 현황

최대주주 및 특별관계자 13.78%, 재무적 투자자 2개 조합 19.49%, 기타 유동주식 66.73%

■ 주주 현황 (기준일: '26.09.30.)



Name	Type	# of shares	%
최대주주 (이성현 대표)	보통주	3,696,811	13.45%
특별관계자 (3인)	보통주	91,942	0.33%
에이티넘성장투자조합2023	보통주	2,106,888	7.66%
	전환우선주	1,145,278	4.17%
	소계	3,252,166	11.83%
스톤브릿지 신성장4.0투자조합	보통주	2,106,888	7.66%
기타 유동주식	보통주	18,344,001	66.73%
Total		**27,491,808**	**100.00%**

※ '26.09.30 주주명부 기준이며, 최신 지분 현황은 DART 전자공시 참조